

深圳市江波龙电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	天风证券、德邦基金、中邮基金、华泰资产、太平资产
时间	2026年3月4日(周三) 10:00-11:00 2026年3月4日(周三) 13:30-14:30 2026年3月4日(周三) 15:00-16:00 2026年3月4日(周三) 16:00-17:00
地点	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号鸿荣源前海金融中心二期B座2301
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 许刚翎 投资者关系经理 黄琦 投资者关系资深主管 苏阳春

投资者关系活动
主要内容介绍

1、如何看待公司主控芯片的技术能力？如何看待主控芯片的市场壁垒？

答：公司目前已推出了应用于 UFS、eMMC、SD 卡、高端 USB 等领域的多款主控芯片。公司主控芯片采用领先于主流产品的头部 Foundry 工艺，采用自研核心 IP，搭配自研固件算法，使得公司各类存储产品具有明显的性能和功耗优势。

在旗舰存储产品上，全球目前仅有包括公司在内的少数企业，具备在芯片层面开发 UFS4.1 产品的能力，而搭载公司自研主控的 UFS4.1 产品在制程、读写速度以及稳定性上优于市场可比产品。基于领先的主控芯片能力，公司已与多家晶圆原厂及头部智能终端设备厂商构建了深度合作关系，搭载公司自研主控芯片的 UFS4.1 产品正在批量出货前夕。

2、如何看待 mSSD 产品的市场空间？mSSD 产品的研发及量产难点在哪？

答：公司 mSSD 作为传统 SSD 的升级形态，通过 Wafer 级系统级封装 (SiP)，实现轻薄化、紧凑化，在满足存储协议低功耗要求、大幅降低空间占用的同时，保持了与传统 SSD 相当的性能水平，并具备更优异的物理特性和综合成本优势。

mSSD 作为一项重大的产品创新，市场前景广阔。围绕该产品，公司已经构建了丰富的知识产权布局，并基于自主高端封测实力，实现了技术从研发验证向实际商业落地的顺利转化。

3、公司与哪些存储晶圆原厂有深度的合作？晶圆供应紧缺是否会影响公司的采购节奏？

答：公司已与全球主要存储晶圆原厂建立了深层次、多角度的合作关系，并签署有长期供货协议 (LTA) 或商业合作备忘录 (MOU)，在存储晶圆供应方面具备较为深厚的基础。

	<p>公司依托主控芯片、固件算法、封装测试的全栈能力，以及和上下游的深度协同机制，在晶圆供应结构性偏紧的环境下，构建起了差异化的供应保障能力与成长潜力。</p> <p>4、公司目前整体库存和出货策略？</p> <p>答：公司结合存储市场的行业情况，以及产品特点、客户结构等自身特征，制定并执行适合公司的生产经营节奏，适时进行备货采购。</p> <p>5、如何看待本轮周期的持续性？</p> <p>答：结合第三方机构信息来看，随着 AI 推理在系统架构与资源调度等方面的结构性变化，特别是键值缓存（KV Cache）与检索增强生成（RAG）技术的应用，AI 推理对存储的容量需求显著扩大，叠加 AI 基础设施快速扩张与 HDD 供应短缺，共同推动存储需求爆发式增长；受制于产能建设周期的滞后性，存储原厂资本开支回升对短期供应的增量贡献也将较为有限。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>